

**SEMICON JAPAN VIRTUAL 2020に出展します！！**

ライブ配信期間：2020年12月14日(月)～2020年12月17日(木)

オンデマンド配信期間：2020年12月11日(金)～2021年1月15日(金)

会場URL <https://www.semiconjapan.org/jp>

上記URLよりIDとパスワードを発行し、ログイン後ロビーより入場下さい

新製品

## 超音波カッティング装置 CSX501

2020年12月1日販売開始



**生産性・機能性向上と  
遠隔監視機能を搭載**

- 生産性の向上
- 装置の状態監視機能
- 省フットプリントの実現
- オプションの充実

**展示会は入場料無料です！！**

**是非TAKADAブースへご来場下さい**

※会場入場には事前登録が必要です



気になる製品は、チャットや  
Web会議方式で質問できます

# 主な展示製品 超音波カッティング装置／枚葉式ウェット処理装置



NEW

## <超音波カッティング装置(量産用途)>

SiCウエハやセラミックス基板を  
超音波アシスト切断により高速・高品質で  
ダイシング加工する『CSX501』

## <超音波カッティング装置(断面観察試料作製用途)>

不良箇所の解析、品質改善などの工程内の  
品質管理及び、研究開発の観察用途など、  
幅広い分野で使用され続けている  
断面観察用カッティング装置『CSX-100Lab』



## <枚葉式ウェット処理装置>

有機剥離・洗浄・リフトオフと1台でフレキシブルに  
対応する枚葉式ウェット処理装置『TWP』シリーズ

詳しくは、お電話またはホームページから TEL:093-632-2600

URL: [https://www.takada.co.jp/jigyo/usw/usw\\_cutting.html](https://www.takada.co.jp/jigyo/usw/usw_cutting.html)

**TAKADA**

株式会社 高田工業所  
装置事業部  
北九州市八幡西区築地町2-1

超音波カッティング装置 高田

